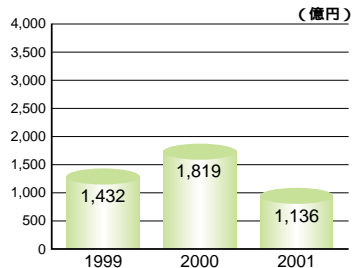


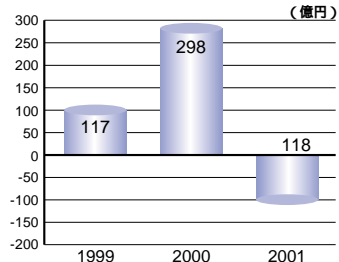
電子デバイス

カンパニー シリコンソリューションカンパニー( SiSC )  
ベンチャーカンパニー オプティカルコンポーネントカンパニー( OCC )

売上高(外部顧客向け)



営業利益



主な商品

システムLSI、ロジックLSI、メモリLSI、メモリモジュール、光ファイバモジュール、光機能モジュール、半導体レーザー、GaAsICなど

当期の売上高は、半導体市場の常態を超える需要減少と価格下落、および米国通信市場の投資需要減退により通信用光部品も打撃を受け、前期比38%の減少となりました。

当セグメントにおきましては、下記のような事業活動を行いました。

急激な市況の変化に対応すべく、パソコン向け汎用DRAMからの撤退とロジックLSIおよびシステムLSI分野へのシフトを行い、携帯電話などの通信ネットワーク市場、パソコン周辺および携帯機器などの民生システム向けメモリ市場に注力してまいりました。



高音質低消費電力で好評を博している沖の音源LSIを用いた携帯電話

近距離ネットワーク用無線通信規格Bluetooth™向けLSIでは、日本企業で初めて最新商用規格Bluetooth Ver1.1の認証を取得し、受注拡大を図り、また、通信用LSIおよび携帯電話用音源LSIなどの新商品の市場投入により販売力の強化に努めました。



携帯電話、パソコン、AV機器などを無線でつなぐ近距離ネットワーク向けBluetooth用LSI

Bluetoothは、Bluetooth SIG, Incの商標です。

低消費電力LSIの分野におきましては、民生用として世界に先駆けて完全空乏型SOIデバイスの量産出荷を開始し、注目を集めています。

また、半導体供給の安定化を図るため、当社の技術供与を受け上海に半導体工場を建設中のグレースエレクトロニクス社との関係を強化するとともに、ユー・エム・シー・ジャパン社との回路線幅0.22μmのCMOS製造技術の共同開発などを行っています。



時計用カスタムLSI 0.35 SOIプロセスを用いて超低消費電力化を実現した、電波ソーラーウォッチ (写真提供:カシオ計算機株)

光コンポーネント分野におきましては、主力商品である10Gbpsに加え40Gbps対応の超高速デバイスやモジュールおよび高出力光モジュールなどの新商品を市場に投入いたしました。これらの販売拡大に向け、テクニカルサポートの充実により米国市場へのアクセスを強化するとともに、米国市場や光通信市場以外の新市場への売り込みを行いました。